

科技部 函

地址：台北市和平東路二段106號

聯絡人：潘敏治 副研究員

聯絡電話：02-2737-7983

傳真：02-2737-7673

電子郵件：mcpa@most.gov.tw

受文者：銘傳大學

發文日期：中華民國106年9月7日

發文字號：科部工字第1060070326號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：本部工程司推動107年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」，自即日起接受申請，請查照。

說明：

一、本計畫申請人依本部補助專題研究計畫作業要點，研提計畫申請書(採線上申請)；申請人之任職機構應於106年11月20日(週一)前備函送達本部(請彙整造冊後專案函送，逾期恕不受理)。

二、本計畫規劃將整合學界研發能量與資源，鼓勵學術團隊參與，並與產業共同合作，建立關鍵自主技術及增加附加價值。

三、計畫之研究主題必須具有前瞻性、關鍵性及創新性，計畫內容必須陳述國內外現狀及所欲達成之技術指標，同時，必須陳述四年計畫規劃藍圖(roadmap)及執行內容，並具體說明階段性成果與後續產業化成效。

四、本部對執行計畫每年進行審查，執行團隊必須定期提報計畫執行進度與成果，並出席各項審查會議，各執行團隊須能展示該計畫所開發之技術或系統成果。

五、本計畫徵求公告相關內容業已公佈於本部工程司網站

(<https://www.most.gov.tw/eng/ch>)-公告事項。

正本：國立臺灣大學等303個機構

副本：本部綜合規劃司、工程技術研究發展司

部長陳良基

【簽辦紀錄 - NO.171820】

秘書處-外文處理者, 藍淑貞 (2017-09-07 12:41, 附件異動)

秘書處-登記桌, 賴數淑 (2017-09-07 13:00, 分文)

研究發展處-登記桌, 高維翎 (2017-09-11 08:19, 分文)

研究發展處-研究暨評量組-一般職員, 李心怡 (2017-09-11 08:54, 陳核): 一、本計畫申請, 意者請詳閱徵求公告計畫重點說明, 於106年11月13日(星期一)中午12時前於線上提出申請, 並致電研發處(分機2651)確認, 以利彙整辦理。

二、擬呈核後公告, 並另函轉知資訊學院。

研究發展處-研究暨評量組-組長, 李孟真 (待處理)